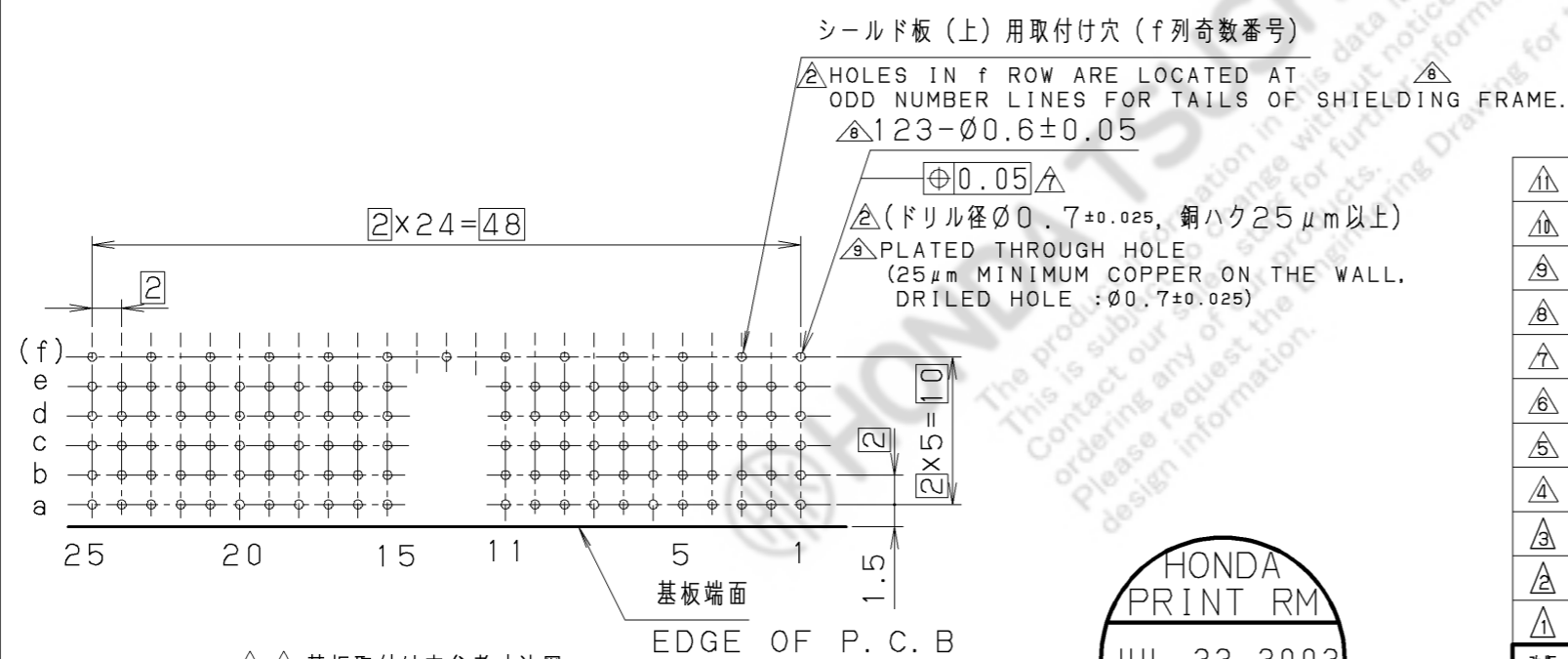


注1. 処理 接触部: ニッケル下地金めっき (0.8 μm以上)
 プレスイン部: ニッケル下地金めっき (0.05 μm以上)

注2. シールド板 (上) はコネクタに装着してあります。

NOTE1. CONTACT AND SHIELDING FRAME PLATING
 CONTACT AREA: 0.8 μm GOLD MINIMUM OVER NICKEL
 PRESS IN AREA: 0.05 μm GOLD MINIMUM OVER NICKEL

2. SHIELDING FRAME (UPPER) IS INSTALLED TO THE CONNECTOR.



基板取付け穴参考寸法図
 RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
 CONNECTOR SIDE
 P.C.B THICKNESS: 1.6mm

HONDA
 PRINT RM
 JUL.22.2002
 ISSUED

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	留数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△	JUL.16.2002	K. O	Form change of an Insulator A B						
△	DEC.03.2001	S. M	RESHAPE						
△	MAR.27.2001	K. O	RESHAPE						
△	FEB.27.2001	S. M	RESHAPE	4	Shielding Frame (Upper)	Phosphor Bronze	1	SEE NOTE1	△
△	DEC.18.2000	K. O	RESHAPE		シールド板 (上)	りん青銅		注1参照	
△	JUN.22.2000	K. O	RESHAPE	3	Insulator B	PBT Resin	22		UL94V-0 Gray
△	JUN.19.2000	K. O	RESHAPE		絶縁体 B	PBT樹脂			UL94V-0 グレー
△	APR.27.2000	K. O	RESHAPE	2	Contact	Phosphor Bronze	110	SEE NOTE1	
△	NOV.08.1999	A. S	ALTERATION		コンタクト	りん青銅		注1参照	
△	AUG.24.1999	A. S	ALTERATION	1	Insulator A	PBT Resin	1		UL94V-0 Gray
△	AUG.20.1999	A. S	ALTERATION		絶縁体 A	PBT樹脂			UL94V-0 グレー

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	留数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年 月 日	DATE	尺 度	SCALE	単 位	UNIT	3 角 法	本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
03.23	MAR.23 (1999)	2 / 1	mm (INCH)	3RD. A. P	名 称 METRIC 雌コネクタ (ライトアングルプレスインタイプ) HARD METRIC FEMALE CONNECTOR (TYPE OF RIGHTANGLE PRESS IN)				
製 図	設 計	検 査	検 査	承 認	名 称	製 番 NCB-SUK110LFPG			
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	名 称	REV.			
K. OOKU	K. OOKU	K. ONO		H. EBIHARA	名 称	11L			
					製 番	PART NO.			